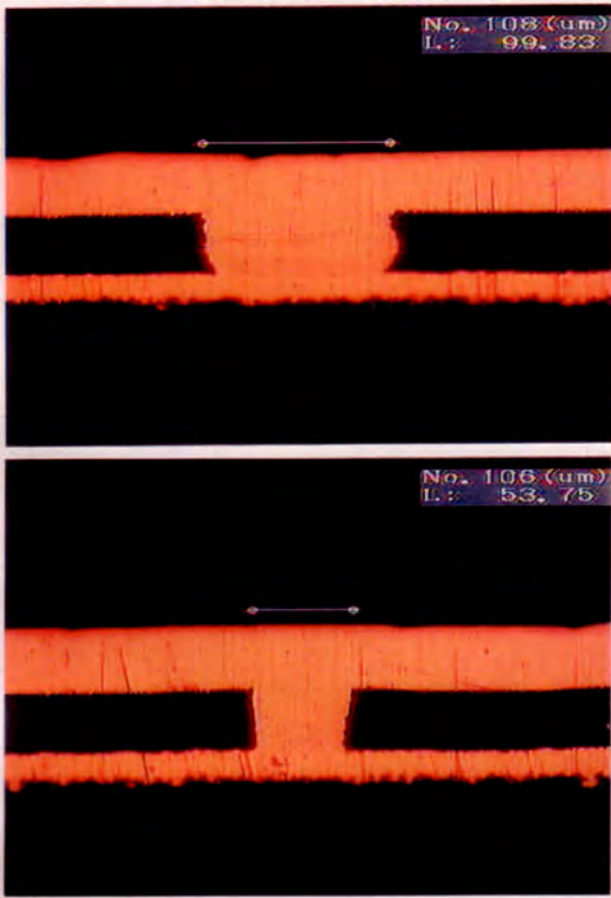
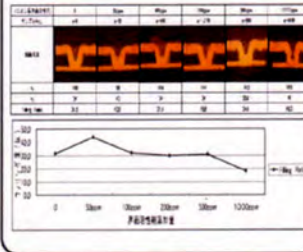


研究開発 - フィルドピア銅めっき技術

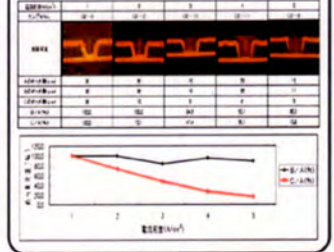
BVH穴埋め銅めっき断面写真



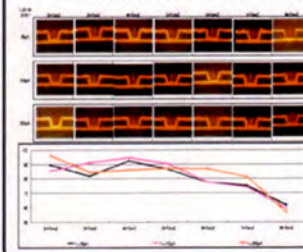
ノニオン系界面活性剤の添加効果



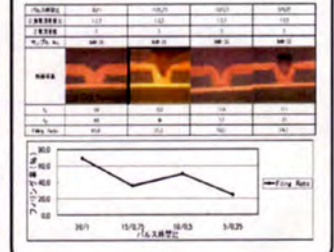
電流密度とめっき均一析出



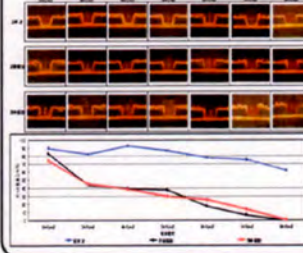
銅濃度の違いによる影響



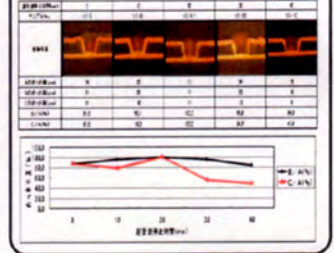
パルス時間比変化によるピッチングへの影響



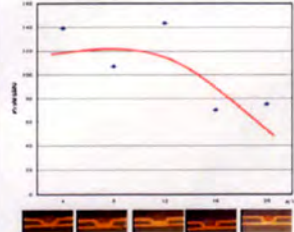
振動と、超音波との効果の違い



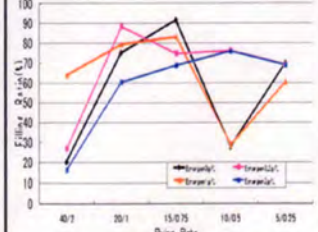
超音波時間とめっき均一析出



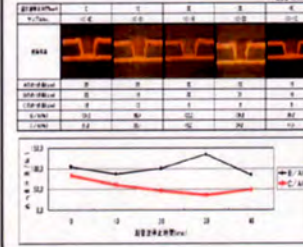
レバラー剤の検討 (ポリアクリルアミド)



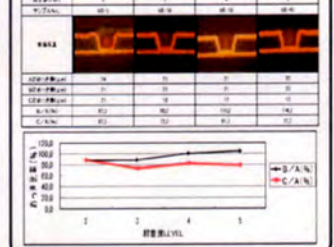
A Relation Between The Pulse Rate and The VIA Filling Ratio



超音波時間とめっき均一析出



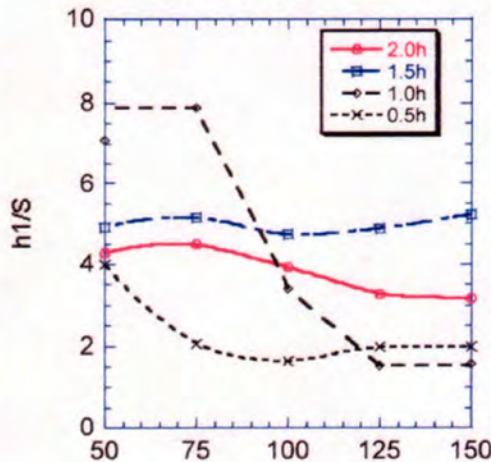
超音波の強度とめっき均一析出



ノニオン系界面活性剤

エソレン 2g/L 63.2	エソマイド 2g/L 55.6	エマゲンLS-100 2g/L -
フタスツァー HS-410 2g/L 42.9	フタスツァー HE-900 2g/L 45.8	ヘツノール O-5 2g/L 105.6
ペーエス US184 2g/L 62.5	リョコックス NC-20 2g/L -	リョコックス NC-60 2g/L 81.3
リョコックス DT-600S 2g/L 57.9	リョコックス SC-50 4g/L 60.0	リョコックス SC-90 5g/L 56.2

Via diameter



キャリアー剤 (酸素含有高分子化合物) の検討

